

倒装芯片助焊剂WS-446

简介

倒装芯片助焊剂WS-446是一款水溶性的倒装芯片浸蘸型助焊剂，其活性很强，可以极好地润湿大部分麻烦的金属化表面。此助焊剂的颜色是醒目的红色，有助于自动化的料位计的使用和增强肉眼检查的效率。

特点

- 专门为倒装芯片浸蘸型应用设计
- 粘性能在封装过程中粘住大芯片
- 无气泡真空包装
- 醒目的红色有助于检测

属性

属性	数值	测试方法
助焊剂类型	H1	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 & 2.3.33)
典型黏度	9kcps	Brookfield HB DVII +CP (5rpm)
典型酸值	71mg KOH/g	滴定法
表面绝缘电阻 SIR (ohms, 清洗后)	合格	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
回流后残留物比重 (典型值)	<10%	TGA数据
典型粘性	570g	J-STD-005 (IPC-TM-650: 2.4.44)
保质期	3个月 (5~25°C) 6个月 (-20~5°C)	黏度变化/显微镜检查

所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

应用

WS-446应使用氧气低于50ppm的氮气气氛进行回流。
WS-446可以在包括浸银、铜、镍等多种表面上使用。这些表面可以用SnPb或者无铅合金焊接。

助焊剂深度应被设定为倒装芯片焊点高度的30%-50%。

清洁

WS-446的残留物可以用去离子水或者添加了清洗剂的水溶液进行清洗。喷雾清洗的理想条件为温度高于25°C (室温)，压力大于60psi，清洗时间超过1分钟。



技术服务

钢泰公司拥有经验丰富的国际工程师可为我们的客户提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面，其快速应答和随时提供现场技术支持的高品质服务设立了行业标杆。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务，将第一时间回应所有技术咨询。

安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：
<http://www.indium.com/sds>。

翻页 →

倒装芯片助焊剂WS-446

包装

WS-446通常用10cc和30cc的注射器包装。

储存

为了保证最长的保质期，WS-446应尖头朝下储存。

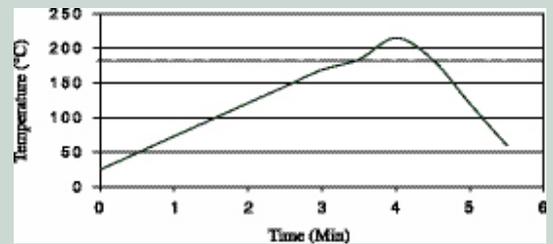
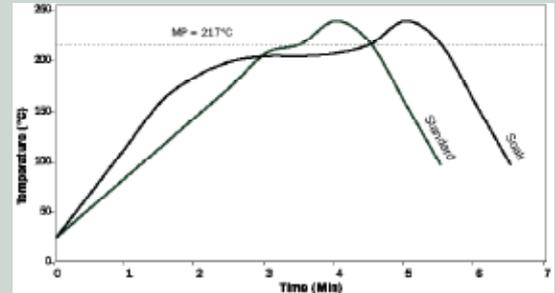
- 3个月 (5到25°C)
- 6个月 (-20到5°C)

储存温度不应该超过25°C。提前至少4小时将WS-446从冷藏环境中取出，从而保证其使用前能升温到工作环境温度。



回流

推荐的温度曲线



回流的峰值温度应该低于350°C（氧气低于50ppm的氮气气氛），达到液相线温度后，采取线性曲线升温，不超过30°C。这些曲线为推荐的初始参考，用户应针对特定的制程需要优化。

本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络: china@indium.com

更多详情: www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900

